

TZ-602 型自动探针测试台

高速机型，可实现遮光测试。主要用于管芯大小 $\leq 1\text{mm}$ 、压焊点 $\geq 100\mu\text{m}$ 的半导体器件，光电元件芯片的自动中测，与相应测试仪连接后，能自动完成对各种晶体管芯的电参数测试及功能测试。

主要技术特点：

1. 全封闭立式结构，进口导轨丝杠工作台，高速精密半闭环控制方式
2. 支持测试仪及设备一体化（预留有集成空间）
3. 支持遮光测试、可测光敏元件
4. 可调式分离针探头测试（探卡测试另选）
5. 单片机控制系统主控
6. 256色真彩显示屏（7"）
7. 全中文操作系统
8. 具有探高测试功能
9. 同步/延时打点任选
10. 手动/自动测试任选
11. 自动测试方式灵活多样（矩阵、探边、圆形）
12. 具有掉电保护功能
13. 系统帮助与各种提示信息
14. 公/英制步距

主要技术指标：

- 可测片径：3"、4"、5"、6"
- 显微镜：放大倍数 14X~90X
- 工作台行程：200mm×280mm
- 工作台速度：X：300mm/s Y：100mm/s
- 步进分辨率：0.005mm
- 定位精度： $\leq 0.01\text{mm}$
- 重复精度： $\leq 0.003\text{mm}$
- 步距范围：0.005~99.999mm/0.001" ~9.999"
- Z向行程：0~3mm 可调
- Z向精度： $\pm 0.003\text{mm}$
- Z向分辨率：0.004mm
- θ 向调节范围： $\pm 15^\circ$
- 外形尺寸（长×宽×高）：725mm×650mm×1400mm
- 重量：200 kg
- 功率：0.5kW
- 电源：AC 220V $\pm 22\text{V}$ 50Hz $\pm 1\text{Hz}$
- 真空：0.08MPa（用户自备）
- 使用温度环境：15℃~25℃
相对湿度： $< 70\%$
- 延时打点个数：1~3个
- 测试仪接口：TTL、RS232
- 最大可布探头数：5支、打点器2支、探边器1支

